

# 13th International Conference and Exhibition on DEVICE PACKAGING 出展

## 1 期間・会場

開催期間 2017年3月7日～3月8日(2日間)  
 会場 Fountain Hills, Arizona USA  
 WeKoPa Resort & Conference Casino

## 2 概要

iMAPS (International Microelectronics Assembly and Packaging Society) が主催する半導体の2.5D/3D実装技術に関する国際学会(13th International Conference and Exhibition on DEVICE PACKAGING)が米国アリゾナ州で開催され、東光高岳は、対流加熱式温度可変反り検査装置およびその技術に関してポスターセッション(学会発表)とブース展示を行った。

展示会には全世界から63社が出展し、約600名の来場者があった。今回、コーポレートスポンサーの登録を行い、会場の入り口や展示会プログラムに社名/ロゴマークを掲載することでも、業界における東光高岳の認知度向上を図った。

東光高岳ブースには約20社の来訪があり、東光高岳の技術や装置に高い関心をもっていただけた。

海外からの新規受注獲得に向け、継続フォローをしている。



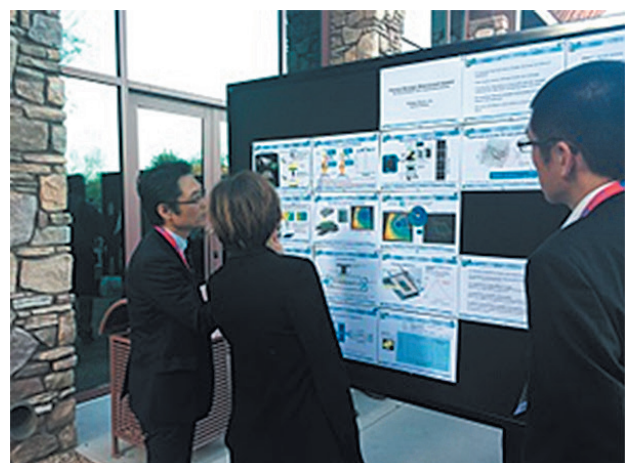
東光高岳ブース



会場入り口



Corporate Sponsor



ポスターセッション

注) 本稿に記載されているロゴ、社名は、それぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。